



# AK-145 高導熱非矽質導熱膏

## 特 點

- 為環氧樹脂基材的導熱膏，非屬矽質系統，無滲油問題。
- 高熱傳導係數 20.0 W/mK。
- 塗抹後不會硬化，易於使用，去除方便，重工性佳。
- 符合 RoHS 2.0 規範。

## 用 途

- 幫助降低發熱元件溫度，或是加強導熱傳熱的應用。
- 可應用於 5G、電動汽車、電晶體、溫控設備、CPU....等各類產品中。

## 基 本 物 性

外 觀	:	灰色膏狀物
黏 度	:	@25°C 70,000 ~ 110,000 cps
比 重	:	2.4 ~ 2.6 g/cm <sup>3</sup>
工 作 溫 度	:	110°C
熱 傳 導 係 數	:	Hot Disk ISO22007-2.2 20.0 W/mK
絕 緣 強 度	:	10 kV/mm
體 積 電 阻	:	>10 <sup>11</sup> ohm-cm
熱 裂 解 溫 度	:	<0.5% (390°C)
U L 阻 燃 等 級	:	UL94 V-0 (內部測試)
包 裝	:	1KG/罐
保 存 期 限	:	@25°C, 未開封 6 個月

## 注 意 事 項

- 本產品含無機填充物，膏體若發生分層現象屬正常情況，須先攪拌均勻後再取用。
- 為免灰塵或雜質影響導熱效果，請於上膠前先針對物件表面進行基本清潔後，再進行上膠程序。
- 塗佈時，盡可能避免產生氣泡，以免影響導熱性能。
- 未使用完的產品請保持容器緊閉，並儲存於乾燥陰涼處且避免陽光直射。
- 主要清洗溶劑為丙酮。

